

報道関係各位

2007年5月14日
サイレックス・テクノロジー株式会社

サイレックス・テクノロジー、真皮指紋認証センサの組み込みモジュール『E1』『E3』の発売開始
～100%のユーザが使える指紋認証機器組み込みをあたりまえに～

サイレックス・テクノロジー株式会社（本社：大阪府東大阪市、社長：河野剛士）は、これまでは困難だった乾燥指の登録・認証に強みを発揮する RF 方式真皮指紋センサを搭載した組み込み用モジュール 2 機種を発売致します。指紋データの読取機能を組み込み先機器へ提供するセンサモジュール『E1』を 2007 年 6 月 15 日から、センサモジュール内で指紋情報の読取りから認証までを実現するインテリジェントタイプの『E3』を 6 月下旬からそれぞれ出荷を開始致します。当社は、国内外の入退室管理装置、金庫、ロッカーやキャビネット、オフィス家具などをはじめとする各種機器に対して、本製品を OEM で販売展開していきます。



真皮指紋インテリジェント認証エンベデッドモジュール 『E3』

『E1』『E3』は、指の表皮状態に左右されない RF 方式の真皮指紋センサ技術を利用することで、乾燥指の読取能力において業界トップレベルの性能を実現しています。指紋認証による本人認証の運用には、全てのユーザの指紋が登録・認証できることが大前提として求められます。しかし静電容量方式や光学式などの従来の指紋センサ技術では、乾燥指と呼ばれる指表面が乾燥している指紋画像が正しく取得できないケースが存在し、100%のユーザ運用を困難にしています。

『E3』の特徴は、センサモジュール内で指紋登録から認証までを完結する自社開発アルゴリズムと専用 CPU を搭載したインテリジェントタイプであり、PC レスの環境でも容易に指紋認証機能の組み込み追加が可能なことです。

『E1』は、指紋登録から認証までの処理をターゲット機器の CPU 内で行います。自社開発アルゴリズムをお客様の機器の環境でお使いいただけるよう、SDK をご提供します。

『E1』『E3』の真皮指紋センサは指が直接センサの検知面に触れないフィルムセンサー構造となっているため、耐久性が高く、センサ面の損傷が懸念される用途への指紋認証機能の機器組み込みの可能性をより柔軟に幅広く提供します。また、指をセンサ面にスライドさせる本スワイプ式センサの性能を最大限に発揮できるよう専用のセンサガイドカバーをモジュールに標準添付しています。

サイレックス・テクノロジーは、『E1』『E3』のリリースにより、主に PC へのログイン用途で使用される IT セキュリティ製品分野で実現している 100%ユーザ運用のコンセプトを、機器組み込みの分野にも積極的に提供していきます。これによって、国内外のユーザ満足度を極大化し、指紋認証機器市場における一層強いリーダーシップを発揮して参ります。

サイレックス・テクノロジーのバイオメトリクス事業について

サイレックス・テクノロジー株式会社（本社：大阪府）のバイオメトリクス事業は、指紋認証製品を開発・販売しています。C&W(Connectivity & Wireless)事業で培った画像処理技術とプリントサーバでは世界納入実績 No1 を誇る組込みノウハウをベースとして、2000 年から事業活動を開始。全てのユーザが安心して利用できるバイオメトリクス製品を目指し、「100%運用可能であること」「生体認証であること」「業界（ISO）標準であること」の3点にこだわった製品事業を展開しています。グローバルな事業展開を進める一方で、製品品質基準を厳格に保つため設計・生産は、国内一貫体制を築いています。当社は JASDAQ(6679)に上場しています。

<ホームページ： <http://www.silex.jp/japan/products/security/index.html> >

◆ 『E3』の製品仕様

●制御 CPU 基板

外形サイズ	60mm × 55mm × 15mm
外部インタフェース	RS-232C
外部 I/O	In: 4bit、Out: 4bit
SD-RAM	8MB
Flash Memory	2MB
搭載アルゴリズム	特徴点抽出方式
電源条件	組込み先機器より供給/電圧 5V±5%/消費電流 5.0V、350mA
環境条件	動作温度:0～70℃/動作湿度:20～85% RH

●指紋センサ

センサタイプ	RF 方式真皮読取型スワイプセンサ
センサエリア	12mm × 18.5mm
解像度	508dpi

※制御 CPU 基板部とセンサ部は 10cm のフラットケーブルで接続

●認証

認証アルゴリズム	特徴点抽出方式
認証精度	本人拒否率(FRR) = 0.1%、他人誤認率(FAR) = 0.001%
登録指数	最大 1,000 指

※E3 を組込み先の上位装置からコントロールするための I/F ソフトを SDK として提供します。

◆ ご参考

『E3』は、5月16日から3日間にわたって東京ビッグサイトで開催される「組込みシステム開発技術展」において当社出展ブース（東 39-28）に出展いたします。なお、「組込みシステム開発技術展」では、本製品に加えて下記の製品群を出展いたします。

●出展予定展示製品

デバイスサーバプラットフォーム	USB2.0、10/100BASE-TX、miniPCI スロットと様々な I/F を搭載、有線/無線 LAN 対応をはじめお客様のニーズに広く対応できる様、考慮された製品です。
無線 LAN モジュール	組込み用途向けにご用意した、802.11b/g、a/b/g 対応した無線 LAN モジュールのご紹介。安定した高速ワイヤレスを実現します。
Wireless Bridge(新製品)	10/100BASE-TX の有線 LAN のみに対応したデバイス無線 LAN 環境でご利用可能にする製品のご紹介。有線 LAN ポートを搭載した、プリンタ・PC・ネットワーク対応カメラ・POS・計測器・監視カメラなど様々な機器に接続可能です。
シリアルデバイスサーバ(新製品)	シリアル I/F しかもたない機器を有線/無線 LAN に接続可能にします。FA 環境・ビル管理システム・医療機器・計測機器などを LAN で共有・管理できます。
ネットワークソフトウェアスイート(参考)	IPv4/v6 デュアル対応の TCP/IP スタックを始めとする各種プロトコルスタック、RTOS を含む基本ソフトウェア等、組込みネットワーク機器開発に必要なソフトウェアモジュールご紹介。

【本プレスリリースに関するお問合せ先】

- サイレックス・テクノロジー株式会社 PR 担当窓口
マーケティング本部（担当: 綱嶋、山本）
E-mail.press@silex.jp Tel.03-3455-2131 Fax.03-3455-5343

- 記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。